

eleXcon



# 第十届中国系统级封装大会 SiP Conference China 2026

2026.8.25-27

深圳会展中心(福田)

All for AI, All for GREEN

为AI和双碳提供全栈技术与供应链支持



扫码了解更多信息

主办方:

eleXcon

第23届

深圳国际电子展  
暨嵌入式展

eleXcon 2026

博闻创意  
Creativity Exhibition

# 大会背景

在人工智能算力需求爆发与摩尔定律放缓的产业根本矛盾驱动下，系统级封装 (SiP) 与先进封装技术已成为突破芯片性能瓶颈的核心路径。

作为中国最具影响力的SiP盛会，中国系统级封装大会自2017年以来，已汇聚全球250余家产业链领先企业及数千名专业观众，构建了前沿技术交流与高端产业融合的关键平台。上一届大会以“智聚芯能，异构互联”为主题，深刻探讨了AI时代的先进封装与Chiplet生态创新，获得业界广泛共鸣。

迈入2026年，产业发展步入从技术验证到规模化落地的攻坚期。面对从云端、智能汽车到边缘设备催生的复杂异构计算需求，以及Chiplet产业化、光电融合等趋势带来的全新挑战，产业焦点正从“为何集成”转向“如何高效、可靠、经济地集成”。

因此，本届大会将紧密围绕“设计与工艺协同”这一核心，设立两大专题论坛，旨在深度拆解从系统架构设计到底层材料工艺的全链条挑战，推动产业务实合作，共同引领下一代系统集成技术的创新与落地。

## 权威

作为全球聚焦于 SiP 系统级封装的重磅活动，历经9年，汇聚全球知名专家、智库和产业链优质资源



## 融合

融合产业链资源，从 IC设计到晶圆制造、封测延伸至终端应用，推动产业链融合创新

## 聚焦

聚焦先进封测领域全新技术及市场动态、应用案例；是业界认可的应用解决方案和产品的发布平台



# 大会亮点

9

成功举办9届(2017-2025)

30

全球30+国家/地区覆盖

25,000<sup>+</sup>

累计25,000+行业人群参与



## 聚焦领域

- ▣ AI芯片
- ▣ 汽车电子
- ▣ 医疗
- ▣ 电子
- ▣ AI能源
- ▣ 物联网
- ▣ 数据中心算力芯片
- ▣ 存储



## 拟邀嘉宾

- ▣ EDA
- ▣ IP
- ▣ AI与算力芯片
- ▣ 存储
- ▣ OSTA
- ▣ 晶圆制造商
- ▣ 封装设备材料商
- ▣ 系统级运用厂商代表
- ▣ 学院研究机构专家
- ▣ 分析机构等



## 目标观众

- ▣ 服务器/智算中心
- ▣ AI硬件厂商
- ▣ 终端品牌商/EMS/OEM/ODM
- ▣ 研发
- ▣ OSAT/晶圆厂/Fabless
- ▣ 功率器件
- ▣ 光电元件等工艺制造
- ▣ 采购及高管

# 热门议题

## 分论坛一：面向AI与Chiplet的先进封装设计创新



AI超算集群的“封装级”  
互连设计挑战



Chiplet互连标准(UCIe)  
的落地实践与生态瓶颈



面向异构集成的系统级  
协同优化与EDA工具演进



智能汽车舱驾一体SoC的  
SiP设计范式

## 分论坛二：突破系统级封装的制造边界与产业链协同



玻璃基板与新型载板技术的  
产业化进程



3D堆叠与混合键合的  
可靠性与量产良率提升



共封装光学(CPO)的  
封装集成解决方案与可靠性



先进封装中的热界面材料与  
散热终极方案

## 参与企业

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

## 往届数据

2025年SiP会议

1564

专业听众人次

40<sup>+</sup>

重磅嘉宾

50<sup>+</sup>

优质企业参与

# 往届嘉宾

排名不分先后



**欧阳可青**  
中兴微电子  
副总经理 IC平台研发中心主任



**代文亮**  
芯和半导体科技(上海)股份有限公司  
创始人&总裁



**陈健**  
阿里云智能集团 首席云服务器架构师  
研发总监 CXL和UCle董事会成员



**祝俊东**  
奇异摩尔(上海)半导体技术有限公司  
联合创始人 产品&解决方案副总裁



**杨蕾**  
IPC  
China标准经理



**KLA**  
Oksana.Gints  
Field Marketing Manager



**李红宇**  
AT&S  
高级经理



**张康**  
成都奕成科技股份有限公司  
研发总监



**张修坤**  
杜邦电子互连科技  
杜邦先进封装中国区销售负责人



**胡清松**  
广东鸿祺芯智能装备有限公司  
销售总监



**谢志杰**  
贺利氏电子  
SEMI业务开发经理



**王宗源 博士**  
华大九天  
市场拓展部高级技术经理



**周军**  
华岭申瓷  
副总经理



**沈里正 博士**  
环旭电子  
微小化创新研发中心 AVP



**何野**  
江苏英特神斯科技有限公司  
CTO



**李建**  
乐普科(上海)光电有限公司  
EQ&WQ 部门经理



**吴政达**  
沛顿科技  
副总经理



**徐健**  
奇异摩尔  
封装设计与运营总监



**Bula Wang**  
AT&S  
技术开发总监



**黄俊贤**  
锐德热力设备有限公司  
德国Rehm华南销售总监



**周强**  
上海光羽芯辰科技有限公司  
创始人兼董事长



**张博威**  
深圳市芯友微电子科技有限公司  
总经理



**赵铁良**  
深圳中科四合科技有限公司  
市场总监



**方家恩**  
苏州锐杰微科技集团有限公司  
董事长



**周乐民**  
武汉新创元半导体有限公司  
载板事业部营销总经理



**李立基**  
西门子EDA  
亚太区技术总经理



**李志成**  
ASE日月光  
工程中心处长



**胡彦杰**  
锦泰公司  
华东区高级技术经理



**赵晓杰 博士**  
英诺激光  
董事长 总经理 首席科学家



**马晓波**  
越摩先进  
研究院院长



**褚正浩**  
Ansys  
EBU ACE Director



**张阔**  
中兴微电子  
先进封装技术总监



**蒲晓龙**  
珠海天成先进半导体科技有限公司  
副总经理

## 大会赞助权益

赞助类别	钻石赞助	铂金赞助	白银赞助	备注
大会演讲时段	✓	✓	✓	25-30分钟/场
独立展位	36m <sup>2</sup>	18m <sup>2</sup>	9m <sup>2</sup>	
大会对外宣传 LOGO展示	✓	✓	✓	
参观指南广告 内页	✓	—	—	实际尺寸: 142x210mm 加出血: 148x216mm
品牌X展架1个	✓	✓	—	尺寸: 80x180cm
宣传资料 入大会宣传袋	✓	✓	—	赞助商印刷提供
赞助套餐优惠价	¥100,000	¥80,000	¥50,000	

## 展位/赞助/演讲申请



0755-88311535 [elexcon.sales@cetimes.com](mailto:elexcon.sales@cetimes.com)